

エレクトロニクス

ファイナルフィニッシュ

Affinity 2.0

Affinity

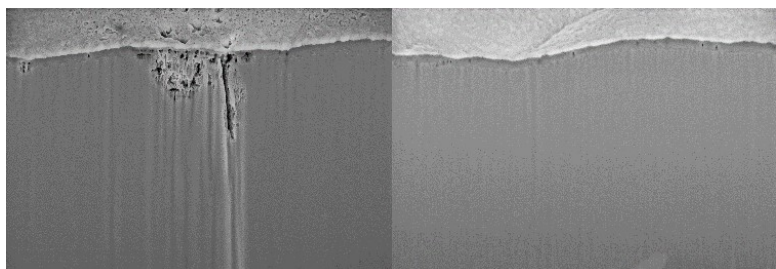
2.0は、従来問題となっていたブラックパッドの発生を抑えることができ、金めっき厚のばらつきが小さいENIGプロセスです。

特徴

- 無電解ニッケルめっきはダミーフリーで使用できます。
- 8~10%の中高リンタイプで、浴寿命が長くリン含有量を一定に保つことが可能です。
- 無電解ニッケルめっき浴のpH及び析出速度を一定に管理できます。
- 金めっき浴は、ガルバニック置換反応を大きく低減することが可能です。
- 金めっきのばらつきが小さいです。

《耐食について》

金めっき浴に含まれている成分の1つが置換めっき時に起こるガルバニック置換反応をコントロールするため、粒界腐食のないきれいな断面が得られます。



従来のENIG

Affinity2.0

粒界腐食が起きている

断面粒界腐食のないきれいな断面

《金めっきのばらつきについて》

置換反応をコントロールすることで、ばらつきが少ない薄く均一な金めっき皮膜が得られます。そのため、従来のプロセスに比べ金めっきのコストダウンが実現可能です。

